**※ 请依本页设定格式撰写复赛计划书，并将此文件上传官网**

**广东省大学生单片机应用设计大赛报告书**

**中文题目(写上你作品题目18pt楷体置中)**

学校：□□□□ 学院：□□□□

指导老师：(用逗号隔开)

参赛队员：(用逗号隔开)

电邮: (填队长一人即可)

参赛编号: 使用单片机型号：

日期:2025年 月 日

**摘要**

摘要部份请简述作品设计目的、设计方案与完成结果，以500字为限，11pt楷体，行高为固定行高15 pt，文字靠左对齐左右边界。并于本栏下方放上作品关键词

**关键词：**(3~5个)例如：数字讯号、图像识别、无人机…

**1. 文章格式**

文章必须采用A4大小的纸张，四边边界皆为2 cm空白，文章摘要之后的内文开始分为两栏，排列须左右对齐。

文章各章节段落标题采用12pt楷体粗体置中，行高为固定行高14 pt。

**具体各章节内容请按照另一份文件：复赛报告书缴件须知来撰写，文章所有内容包括图片、表格、参考文献不超过12页(不含附件)，不加页码。**

**1.1 章节标题、子标题与段落**

章节标题字型采用12pt楷体粗体，子标题字型采用11pt粗体靠左，章节标题与子标题前后留一行空白。每一段落首行以0.6 cm缩排开始。行高为固定行高14 pt。

**1.3 内文**

行高为固定行高14pt，字型采用11pt楷体一般粗细。

**2 图片与表格**

**2.1 图片**

图片可使用一栏或两栏，说明必须置于图片下方且置中。

图1：XX图

**2.2 表格**

表格可以使用一栏或两栏，说明必须置于表格上方且置中。

表1：XX表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3. 参考文献格式**

参考文献字型11pt楷体，左右对齐，行高为固定行高14pt。

**附件一：作品中使用的硬件模块清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **作品使用硬件模块名称、型号、规格** | **硬件厂牌** | **数量** | **用途** |
| **HT32F52352单片机(范例)** | **合泰半导体 (范例)** | **1颗** | **作为主控芯片接收及控制XX等功能(范例)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**作品目前完成度\_\_\_\_%，是否可在决赛5/17日(六)于广东工业大学展出？\_\_\_\_(Y/N)**

**如果无法完成，请说明原因\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。)**

**已完成之作品请放上照片：**

**作品演示视频网址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**可上传到优酷、B站、腾讯视频等视频网站並提供网址**

**附件二：参赛队伍合照**

**范例：**



从左到右：林小美、王大明、张小春、李小强

**照片标准**

1. 所有队员皆须入照，尽量拍摄清晰、背景单纯、服仪整洁。

2. 尽量能涵盖作品在照片中(可用手拿或放置前方)。

3. 全身照或半身照皆可，分辨率尽量在800x600以上。

4. 请于照片下方用文字说明队员姓名。

**附件三：合泰杯团队分工与学习心得调查表 (每位参赛队员皆请填写一页)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **队员姓名：** | **学校：** | **专业：** |
| **年级：** | **预计毕业时间： 年 月** |  |
| **常用E-mail：** | | **联络电话：** |
| **本次竞赛您在作品中分工负责的内容為何：**  1.个人负责工作内容(请概述)：  2.个人在本次作品中负担工作比例(百分比)： | | |
| **参赛学习心得：**(如开发经验、所遇到的困难、解决办法、对您学习单片机帮助等) | | |
| **您对本竞赛活动的建议：** | | |
| **个人学习单片机(不限品牌)经历：**🞎 初学者、🞎 1年经验、🞎2年经验、🞎 3年经验、🞎4年以上 | | |
| **除合泰单片机外，我还学过哪些MCU开发应用：(请写厂牌型号，例如：Holtek/HT32F52352)** | | |
| **对于合泰单片机、开发工具与平台，使用体验与评价为何？有无遇到难解技术问题(请据实填写)** | | |
| **毕业后规划：**🞎继续升学、留学或考公职  🞎毕业求职(预计从事电子相关) 🞎毕业求职(预计从事其他工作) | | |
| **是否愿意收到每年合泰杯竞赛活动成果花絮？**  🞎是、🞎否  **是否愿意收到合泰半导体公司针对应届毕业生的人才招聘相关资讯？**  🞎是、🞎否  填否者请说明原因\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

注:本调查表内容保密，仅限于合泰杯主办单位办理报告书审核与比赛宣传工作，及冠名单位合泰半导体人才招募相关事宜使用，未经允许将不得外流于任何第三方使用。

**合泰杯参赛学生调查问卷：(请点开网址或扫码填写，每队一人填写)**

[**https://wj.qq.com/s2/19603048/e2r3/**](https://wj.qq.com/s2/19603048/e2r3/)

****